

CLB0FB5560K1000TC1

目前生产

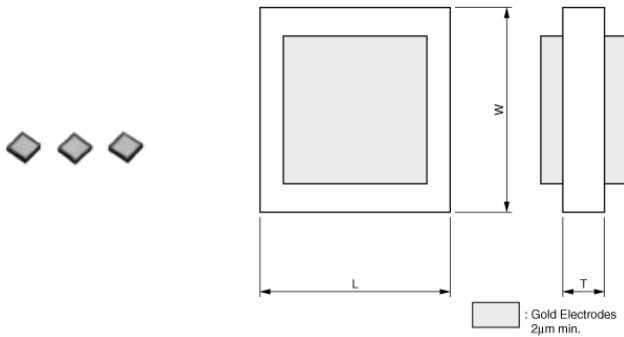
RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备,路由器,无线路由器,光传送装置,光通信模块,移动设备,基站,射频功率放大器,工业设备

外观&形状



特点

1. Fine grained high-density ceramic dielectric, pure gold electrode and simple single layer structure provide very reliable performance and excellent frequency characteristics.
2. A wide selection of sizes from very miniature 0.25mm square is suited to high-density mounting.
3. For compatibility with the gold electrodes, die bonding with Au-Sn is possible and wire bonding with gold wire is possible.
4. To improve handling of bonding, Au-Sn coating is available on one side or both sides.
5. Custom made type (dimensions, cap. values, etc.) are also available upon request.

Applications

1. Microwave Integrated Circuits
2. Microwave Devices
3. Optical Devices
4. Measuring Equipments

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

CLB0FB5560K1000TC1

规格

形状	SMD
工作温度范围	-55°C to 125°C
长x宽	L 0.64 X W 0.64mm
厚度	0.155mm
额定电压	100Vdc
静电容量(25°C)	56pF
静电容量公差	±10%
静电容量变化率(-25 to 85°C)	±10%
耐电压	250Vdc
绝缘电阻	25°C：100000MΩ以上

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。